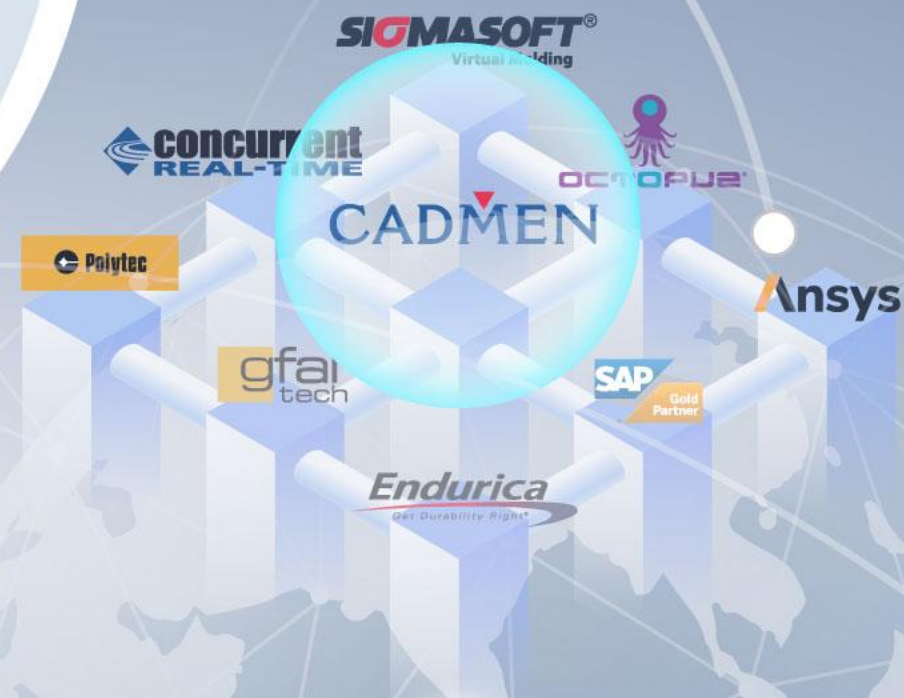


CAD MEN
Taiwan Auto-Design Co. (TADC)

虎門科技(股)有限公司
Taiwan Auto-Design Co.(TADC)

報告人：
楊涪嵐 Frances

股票代號
6791



CAD MEN
Taiwan Auto-Design Co. (TADC)
虎門科技股份有限公司

免責聲明

- 本簡報可能包含對未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。
- 本簡報所使用的資料來源及各項聲明非常可能受到眾多因素(如：最新科技的演進)的影響而造成迥異，因此本公司強烈建議讀者以參考公開資訊觀測站的公告資訊為依據。

股票代號
6791

議程說明

01 公司介紹

02 產品介紹

03 市場分析及趨勢

04 營運概況

05 研發成果

06 未來發展

—— 公司介紹 ——

PART 01

關於虎門



虎門成立於**1980**年



行銷全國



2022年上櫃完成

股票代碼：**6791**

- 公司名稱：虎門科技股份有限公司 / Taiwan Auto-Design Co.
- 資本總額：新台幣208,470,000元
- 負責人：林麗俐 董事長
- 創辦人：楊舜如 策略長
- 主要營業項目：工程系統解決方案、商用系統解決方案、工業4.0

虎門科技 公司沿革

CAD MEN
Taiwan Auto-Design Co. (TADC)

榮獲國家第28屆磐石獎



2019年榮獲中小企業最高榮譽
第28屆國家磐石獎

2.SAP年度最佳貢獻獎

2019

2020

- 1.再度獲得台灣區【SAP B1年度最佳貢獻獎】
- 2.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行

2022



2022年國內第一家CAE解決方案供應商
之上櫃公司 (股票代號: 6791)

2.續獲選台灣區【SAP B1年度最佳貢獻獎】

股票代號

6791

榮獲財政部公開表揚為開立
統一發票「績優營業人」

2023

1980 1983 1992 1994 1997 1999 2002 2004 2009 2012 2018

國內第一家
以CAD/-
CAM專業技
術應用服務
公司

自行研發小型
CAD/CAM系
統

- 1.完成機械所產品製程推廣輔導案
- 2.完成汽車鉗金模製程電腦化
- 3.成為Ansys公司在台灣唯一的代理授權商

開發完成國內自行
研發彈性製造系統

於瑞士日內瓦與世界15
家知名CAE公司，以技
術結盟方式，加入
TECKNET INC.(國際知
名CAE公司技術聯盟)

以「鞋模製程管理系統」
取得軟體五年計劃之
「主力軟體新產品開發
計劃」專案補助

2002年政府指定為知識
型專業技術服務業

- 1.以「液冷式散熱模組創新研發設計」通過政府「促進產業研究發展貸款計畫」
- 2.虎門科技成為台灣首批SAP合作夥伴

通過經濟部工業局
技術服務能量登錄

通過經濟部工業局
技術服務能量登錄

獲得【SAP年度最佳貢獻獎】

自行研發
CAD/CAM
工程軟體

機械所評定為
CAD/CAM系統最
高佔有率的廠商

- 1.完成中文BOM輸出與MRP管理整合之發展
- 2.完成自動化設備圖案監控系統

成為中華民國電腦
輔助工程協會的創
會會員

經濟部工業局「自動化
工程服務機構」登錄合
格

榮獲財政部公開表揚為
開立統一發票「績優營
業人」

- 1.榮獲政府多項肯定
- 2.與韓國FunctionBay公司(RecurDyn)建立戰略發展夥伴

當選2005年研發
服務業標竿企業

推出虎門SAP B1
在地化產業解決
方案Add-On

- 1.通過經濟部工業局技術服務能量登錄
- 2.該年度唯一【SAP金牌合作夥伴】，並獲得【SAP年度最佳貢獻獎】

1982 1984 1993 1996 1998 2001 2003 2005 2011 2014

公司定位

以資訊基礎、協助
產品研發、**管理**、**智慧製造**
三個應用整合之技術服務為
核心價值。



CAE

工程模擬分析

提供研發技術服務及整合世界一流分析模擬平台

研發設計優化

提供技術加值

CPC

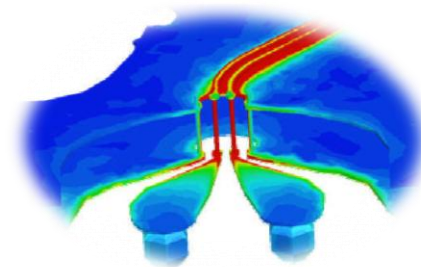
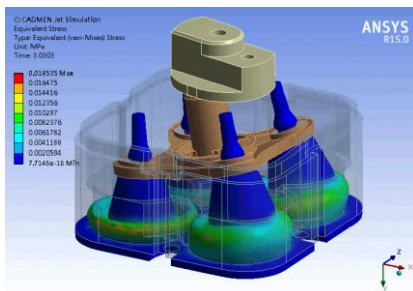
商業管理ERP

提供商用經營管理之全方位整合方案

工業4.0

自動化及智慧化轉型

產業自動化、提供虛實整合方案及系統整合供應鏈



產品介紹

PART 02

CAE(Computer Aided Engineering計算機輔助工程)

CAE系統解決方案主係應用於模擬分析、驗證及設計優化，以數值模擬來分析過去受條件限制而無法分析解決的大量且繁複之工程問題，進而提供最佳化之解決方案。本公司主係以40年累積之研發經驗整合國際著名之CAE軟體平台，協助國內產官學研各界於更快速且準確的解決研發設計及分析新產品開發等方面問題。



主力產品 - CAE系統解決方案

CAD MEN
Taiwan Auto-Design Co. (TADC)
股票代號
6791



結構



流體



電子設計



光學



高階檢測設備

AI

計算機輔助工程(CAE)

結構可靠度分析 解決方案

--主要適用產業--

1. 半導體封裝應用產業
2. 精密工具機產業
3. 電子產品應用產業
4. 學術、國家及法人研究單位
5. 國防

熱流-散熱 解決方案

--主要適用產業--

1. 電子封裝應用產業
2. 消費性電子產業
3. 5G網通通訊產業
4. 高速運算伺服器產業
5. 學術、國家及法人研究單位
- 國防

熱流-潔淨工程與 化工應用解決方案

--主要適用產業--

1. 環境工程產業
2. 工程技術顧問產業
3. 化工產業
4. 半導體產業
5. 鋼鐵產業
6. 學術、國家及法人研究單位

馬達多重物理系統 設計方案

--主要適用產業--

1. 車用馬達產業
2. 風力發電機產業
3. 伺服馬達產業
4. 學術、國家及法人研究單位

計算機輔助工程(CAE)

電力電子 解決方案

--主要適用產業--

1. 再生能源產業
2. 消費性電子產業
3. 車用電子產業
4. 高速運算伺服器產業
5. 學術、國家及法人研究單位

無線收發 解決方案

--主要適用產業--

1. IOT產業
2. 消費性電子產業
3. 網通設備產業
4. 車用電子與無線連接
設備產業
5. 學術、國家及法人研究單位

訊號與電源 解決方案

--主要適用產業--

1. 封裝設計產業
2. PCB設計產業
3. 消費性電子產業
4. 工業電腦產業
5. 網通設備產業
6. 學術、國家及法人研究單位

材料結構分析模組 方案 (OptiMa)

--主要適用產業--

1. 鑄鐵
2. 鑄鋁
3. 層分析橫斷面
4. 層分析Calotte 磨削
5. 創新塗層厚度測量解決方案

聲學、振動及光學量測解決方案

聲學照相機 (Acoustic Camera)

--主要適用產業--

1. 製造業
2. 半導體產業
3. 國防與航太產業
4. 汽車與機車業
5. 工具機產業

尋找異音來源改善環境噪音與機械設備噪音。軟體演算法與獨家的3D Dybeam專利技術可使使用者精確找到異音位置，用於改善與驗證其設計。

WaveCam 振動分析軟體

--主要適用產業--

1. 製造業
2. 半導體產業
3. 國防與航太產業
4. 汽車與機車業
5. 工具機產業

組件、機台振動檢測。可搭配Ansys模擬軟體的結果進行比對應證。

雷射都普勒量測儀 (LDV)

--主要適用產業--

1. 製造業
2. 半導體產業
3. 國防與航太產業
4. 汽車與機車業
5. 工具機產業

組件、機台振動檢測。可搭配Ansys模擬軟體的結果進行比對應證。

白光干涉儀 (WLI)

--主要適用產業--

1. 半導體產業
2. 製造業
3. 鋼鐵與鑄造業
4. 金屬加工

用於量測材料表面特性;可搭配材料分析軟體提供表面計量(Surface Metrology)資訊。

主力產品 - CAE系統解決方案

運算平台

伺服器/工作站

雲端

--主要合作夥伴--

1. 美超微
2. 神雲(泰安)
3. 聯想等大廠



--主要適用產業--

1. Rescale



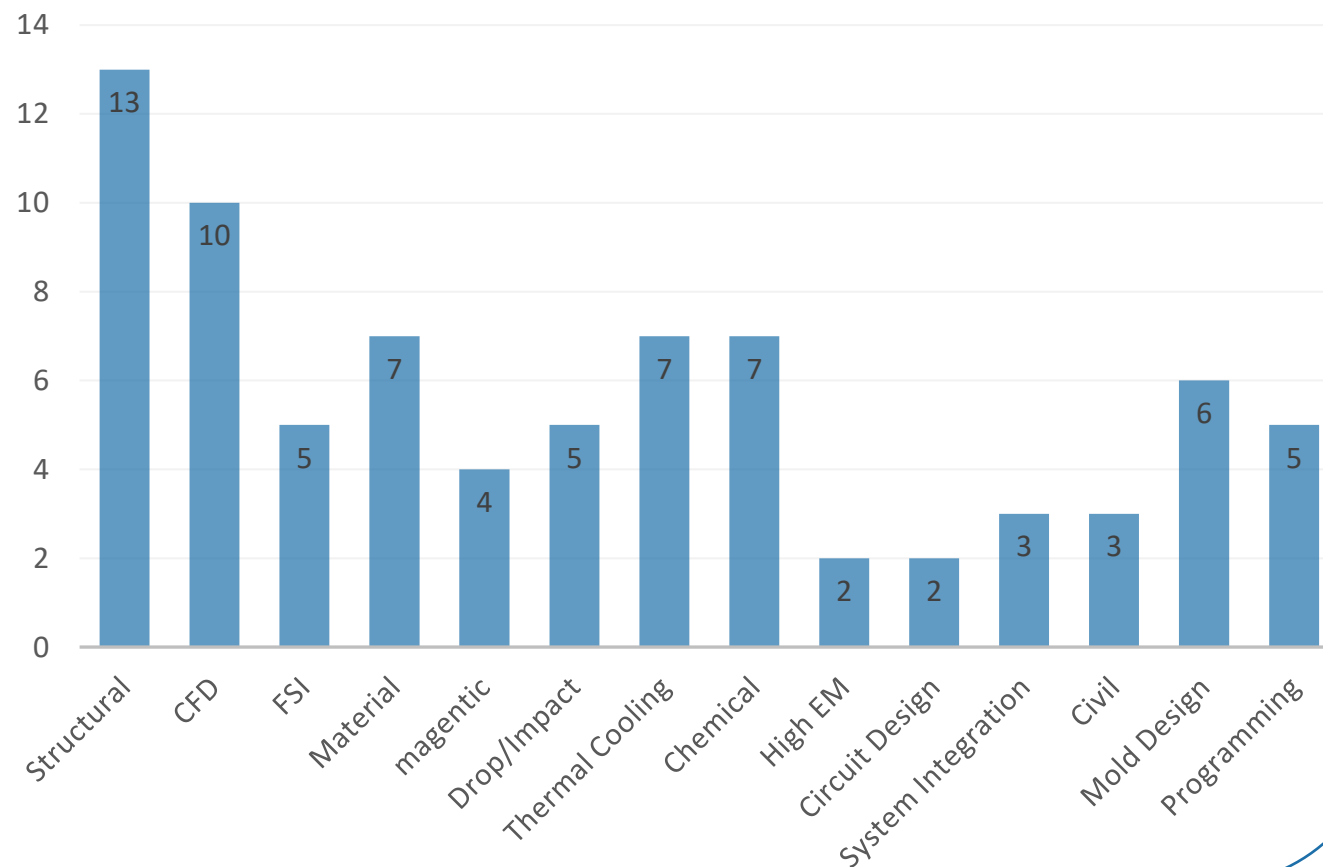
CAE 同業差異及區隔

- ▶ 專注主要產業領域
- ▶ 擁有專業堅強且經驗豐富之技術團隊
- ▶ 自行開發及整合(產業及技術耦合)能力
- ▶ 完整的服務團隊(北/竹/中/南)及訓練中心

CAE 競爭力

- ▶ 技術門檻
- ▶ 市場開拓能力
- ▶ 客戶合作關係
- ▶ 財務狀況(資金)

專家人才領域配置



CPC- (Collaborative Product Commerce 協同產品商務)

CPC系統解決方案主係利用網路技術將企業間價值鏈活動之互動、流程整合、組織再造及標準一致化，透過導入SAP系統可有效整合客戶日常營運流程，以發揮整體營運綜效之經營方式。本公司以客戶的核心競爭力為基礎，協助客戶導入嚴謹穩定之SAP系統，以產業別訂作符合標準之模組，累積產業別解決方案之實力。



45%

啟動企業的數位轉型之旅

- ▶ SAP S/4HANA Cloud 導入服務
- ▶ SAP B1導入服務
- ▶ 穩健升級，助您前行
- ▶ SAP 系統升級服務

60%

啟動數位革新驅動力

- ▶ SAP BTP平台
- ▶ 顧問服務: 自動化
- ▶ 異質資料整合
- ▶ 資料分析與倉儲
- ▶ AI 智能預測

100%

釋放企業潛力的關鍵

- ▶ 值得信賴的 SAP
- ▶ 技術專家
- ▶ 產業專家



SAP 雲端解決方案 與 人工智能應用，驅動業務數位轉型與創新

S/4 HANA

- ERP 導入
- PO/PI 導入
- Fiori 開發
- ABAP 開發
- AMS 維運

SAP BTP

- 自動化
- 簽核系統
- RPA 機器人
- 系統整合
- B2B/ B2C 整合

ESG

- 碳盤查
- 碳足跡
- 碳計劃

AI 智能運算

- 優化生產計劃
- 優化生產流程
- 優化庫存管理
- 優化交期達成率

硬體/雲端

- 地雲網路整合方案
- 智慧化設備維護管理
- 資安規劃與防護服務
- 戰情中心監控與即時回應

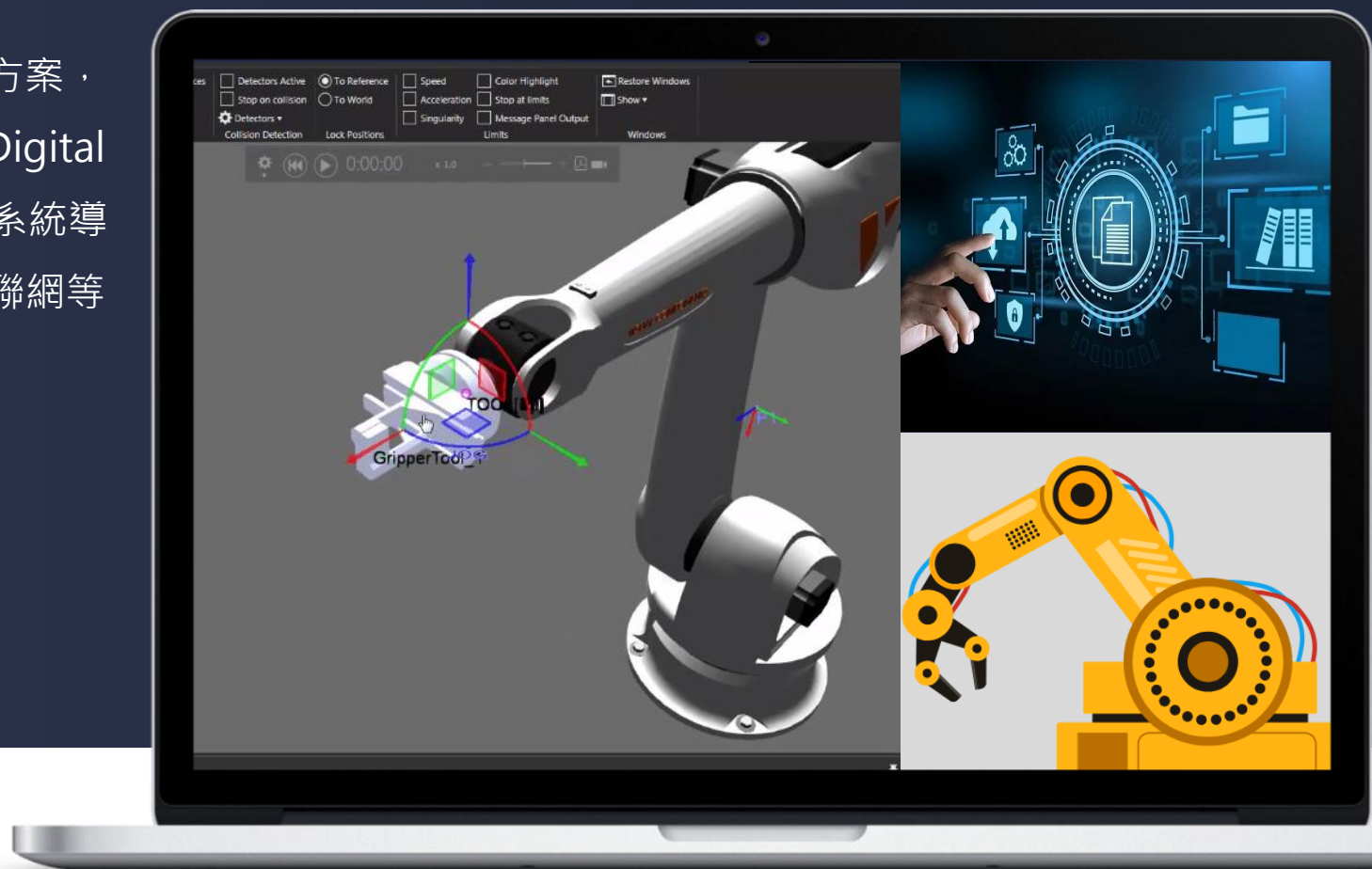
工業 4.0

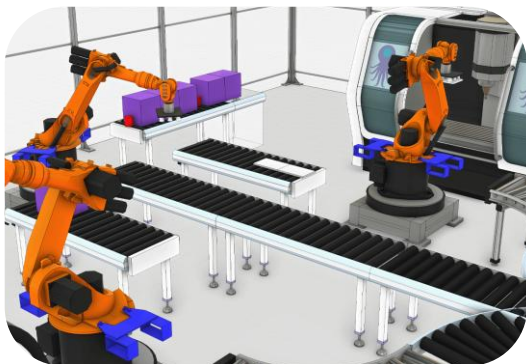
- MES 4.0
- IIOT
- SCADA
- RFID
- OPC/UA

工業4.0

虎門工業4.0 事業部提供工業自動/智慧化解決服務方案，協助客戶導入軟硬體自動化系統，透過虛實整合 (Digital Twin) 縮短設計與整合所需的工時。包含：自動化系統導入、機器人離線編程、MES製造執行系統 + IoT物聯網等技術服務。

- 自動化系統
- MES製造執行系統 + IoT物聯網
- 機器人離線編程
- 視覺檢測+AI學習
- MVCon視覺控制系統





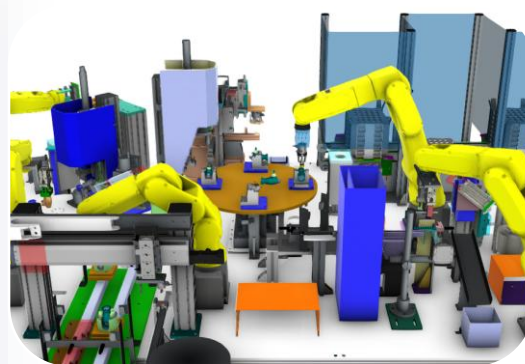
快速提案

大量機器人、無人車等搬運設備的3D規劃模型資料庫，可快速進行方案規劃與評估，協助客戶釐清需求。



設備研發

經驗豐富的研發團隊，透過概念設計、樣品測試、實驗確認，得以加快研發進程並維持良好的設備品質。



虛實整合

透過電腦輔助軟體模擬系統來查察潛在設計風險，使系統節拍與設備間的運作平衡，使生產效率最佳化。



系統製造

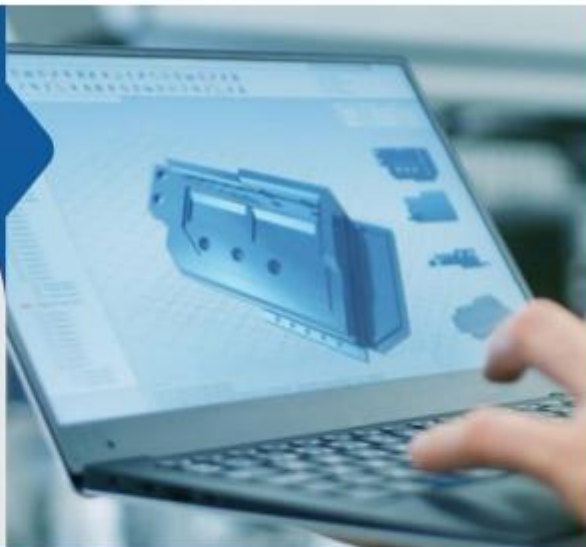
執行團隊具備多品牌的機器人與系統設備整合經驗，使系統整合效率提升。

市場分析及趨勢

PART 03

GLOBAL COMPUTER AIDED ENGINEERING MARKET

The global Computer Aided Engineering Market accrued earnings worth approximately 8.79 (USD Billion) in 2021 and is predicted to gain revenue of about 16.20 (USD Billion) by 2028, is set to record a CAGR of nearly 9.2% over the period from 2022 to 2028.



8.79

Billion US\$

MARKET VALUE
IN 2021

16.20

Billion US\$

MARKET VALUE
IN 2028

2021

2028

CAGR
9.2%
2022-2028

資料來源：111年4月6日 Zion Market Research 「Computer Aided Engineering Market - Global Industry Analysis」

“

依據Zion Market Research於111年4月6日出具之報告觀之，**110年**全球CAE 市場規模約為**87.9億美元**，預計在**117年**全球CAE市場規模將達到**162億美元**。

依照地區特性，CAE(ANSYS)在歐美主要應用在航太領域，而在中國大陸則是汽車領域，至於台灣的產業應用則以半導體和5G領域為大宗市場。

目前，亞太市場佔全球計算機輔助工程 (CAE) 市場價值的 25% 以上。該地區也將在預測期內表現出最高的複合年增長率，這主要是由於最終用途應用行業的穩定發展。如 IC 半導體製造、5G 天線與電動車。

”



“

- 本公司具有專業且龐大之工程師顧問服務團隊，
累積30年技術知識庫能根據客戶的產業、產品、問題需求，在時效內給予相對應的系統解決方案。
- 客戶群涵蓋電子業滲透率超過80%、學界涵蓋率超過95%、公私立機關與財團法人。
- 台灣半導體龍頭指定服務商。
- 台灣區唯一直接與總部下單的**菁英級代理商**(Elite Channel Partner,最高等級)。

”



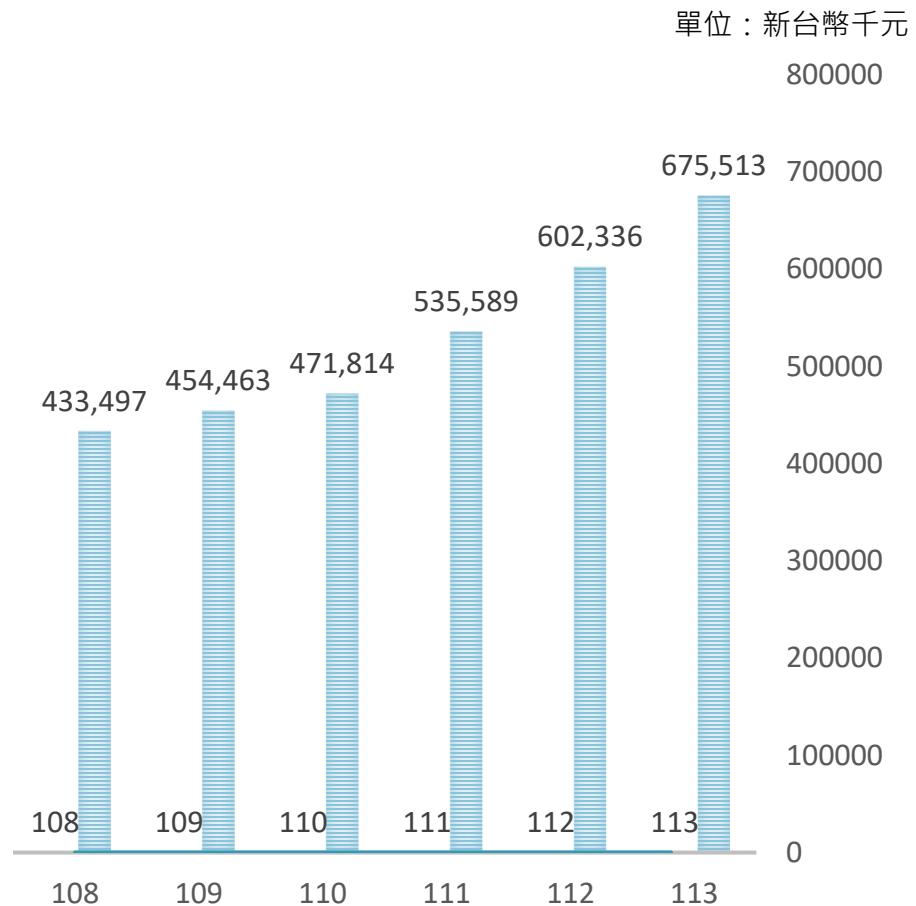
“

- 自2005年SAP台灣區首批代理商以來，虎門科技深耕**國內中小企業市場**。
- 自研**開發專屬SAP B1模組管理**，以符合台灣地區管理所需之解決方案。
例如.媒體申報，電子發票，票據，存貨三表，批次生產，品管..等解決方案。
- 客戶為減低投資成本，實現實務管理需求，我們採化整為零的整合服務輸出。
- 虎門科技CPC部門獲得SAP B1台灣區-**年度最佳貢獻獎**的肯定。
- 2024年**組建S4顧問團隊**，跨足大型模組市場。

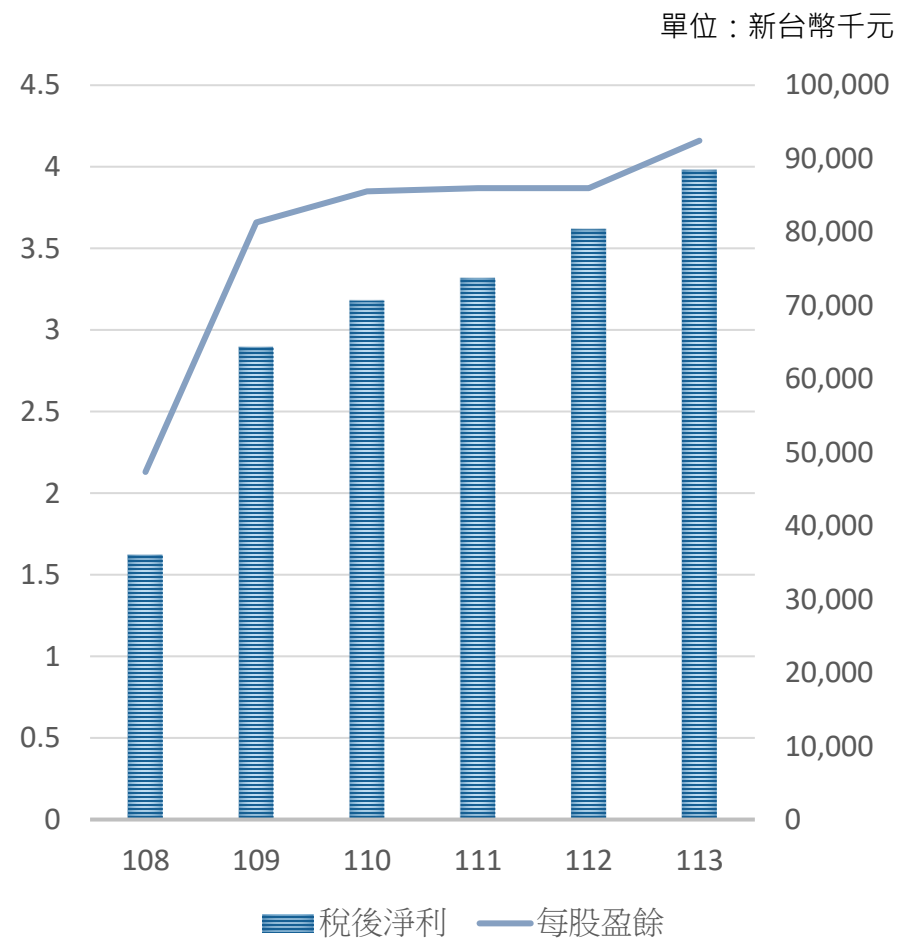
營運概況

PART 04

歷年營收成長



歷年稅後淨利及每股盈餘



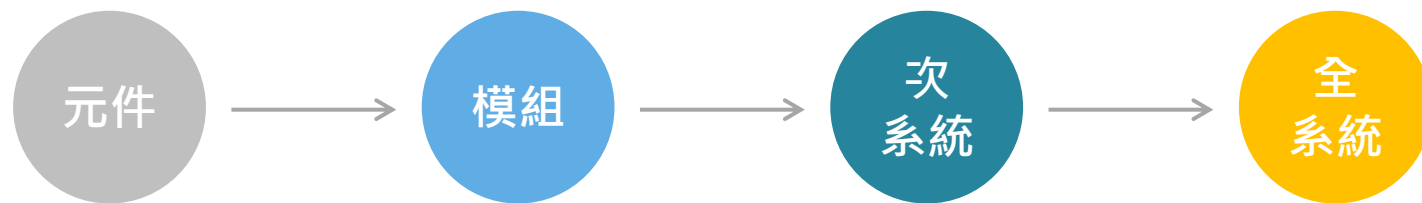
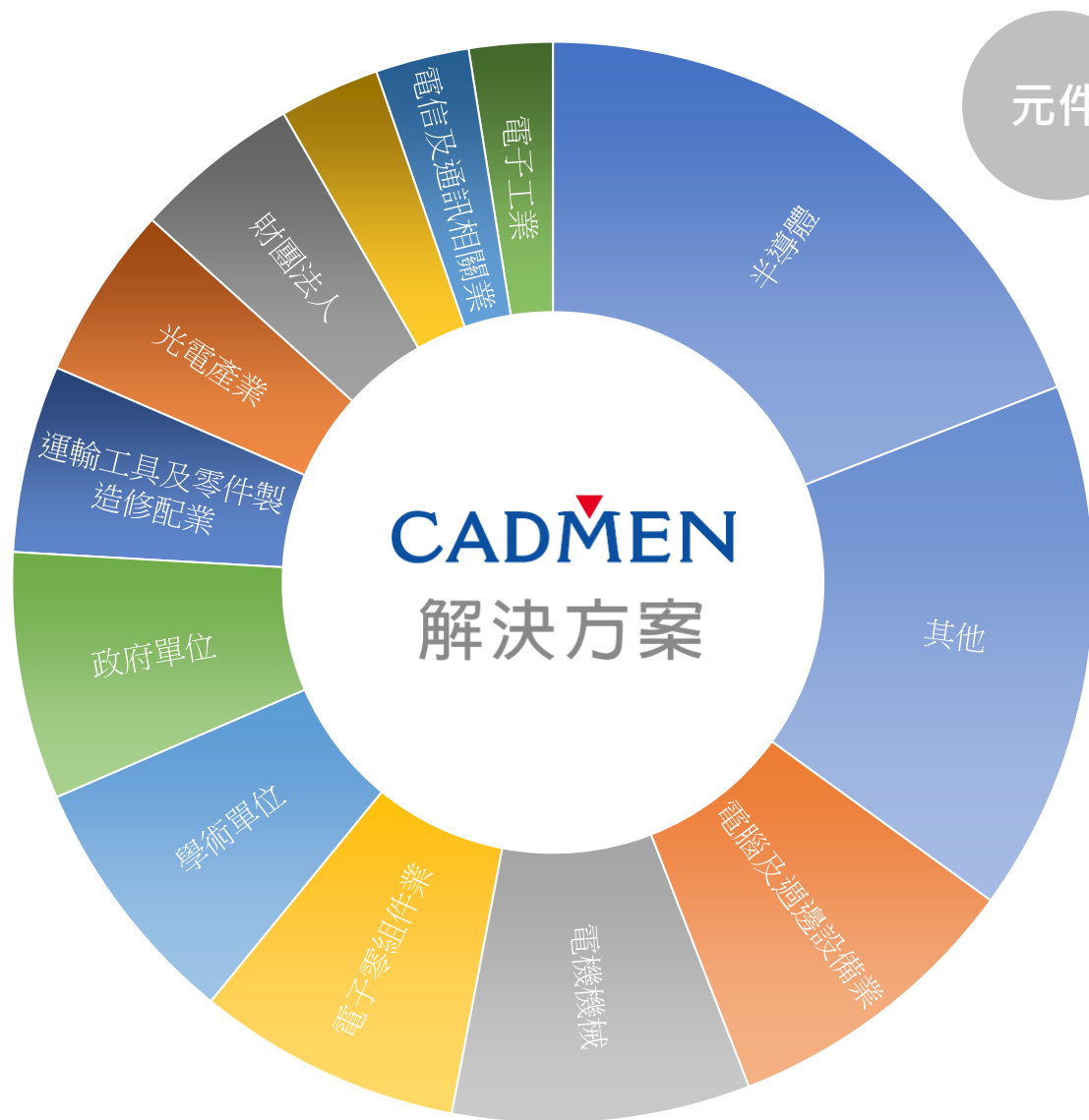
最近三年簡明資產負債表

會計項目	111年12月31日		112年12月31日		113年12月31日		114年3月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產	571,965	79	557,190	75	614,400	73	711,216	79
非流動資產	148,579	21	188,821	25	233,396	27	194,003	21
資產總額	720,544	100	746,011	100	847,796	100	905,219	100
流動負債	239,657	33	254,072	34	339,767	40	409,368	45
非流動負債	35,405	5	32,215	4	32,213	4	31,746	3
負債總額	275,062	38	286,287	38	371,980	44	441,114	48
權益總額	445,482	62	459,724	62	475,816	56	464,105	52
負債及權益總計	720,544	100	746,011	100	847,796	100	905,219	100

最近三年簡明損益表

會計項目	111年度		112年度		113年度		114年度第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	535,589	100	602,336	100	675,513	100	181,181	100
營業毛利	220,475	41	246,149	41	259,427	38	70,018	39
營業費用	136,331	26	159,855	27	175,751	26	49,630	28
營業外收入及支出	6,506	1	11,662	2	23,148	3	5,310	3
稅前淨利	90,650	16	97,956	16	106,824	15	25,698	14
稅後淨利	72,454	13	80,605	13	86,824	13	20,534	12
每股盈餘	3.87		3.87		4.16		0.92	
現金股利配發	3.18086276		3.46940068		3.48141953			





- 半導體
- 電腦及週邊設備業
- 電機機械
- 電子零組件業
- 學術單位
- 政府單位
- 運輸工具及零件製造修配業
- 光電產業
- 財團法人
- 其他電子零組件相關業
- 電信及通訊相關業
- 電子工業
- 其他

■ 其他

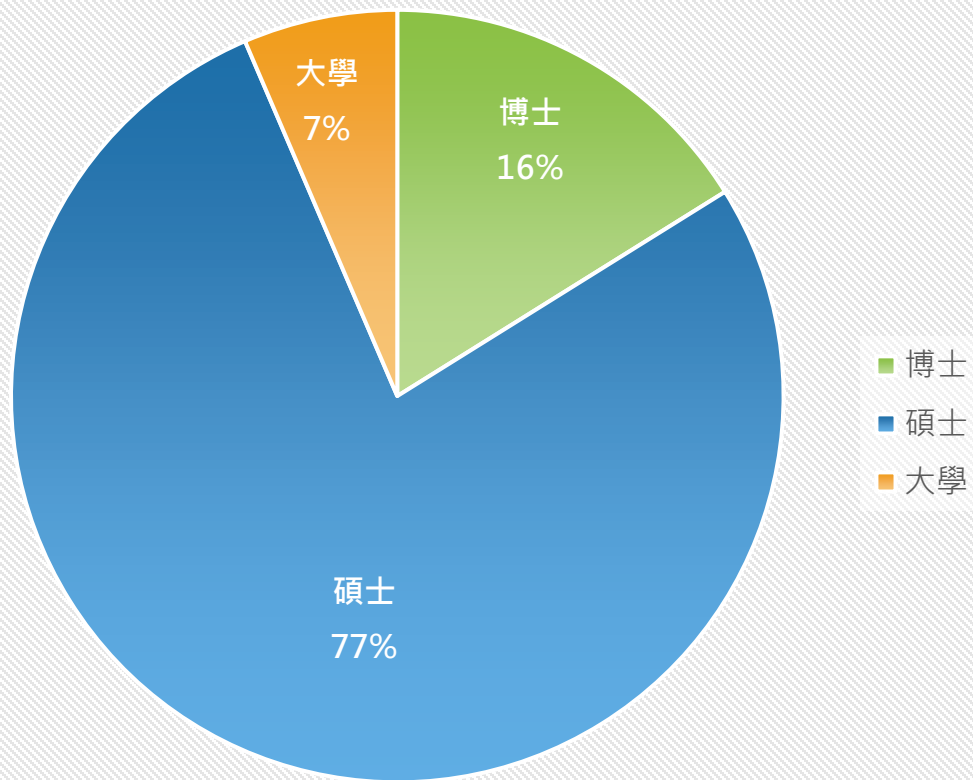
- 電池製造業
- 生技醫療產業
- 電腦軟體服務業
- 工程顧問
- 塑膠工業
- 鋼鐵工業
- 精密儀器相關製造業
- 消費性電子產品製造業
- IC設計
- 系統整合
- 文化創意業
- 石化
- 自動控制相關業
- 其他金屬相關製造業
- 化學產業
- 電力機械器材製造修配業
- 通用機械設備製造修配業
- 專用生產機械製造修配業
- 其他機械製造修配業

研發成果

PART 05

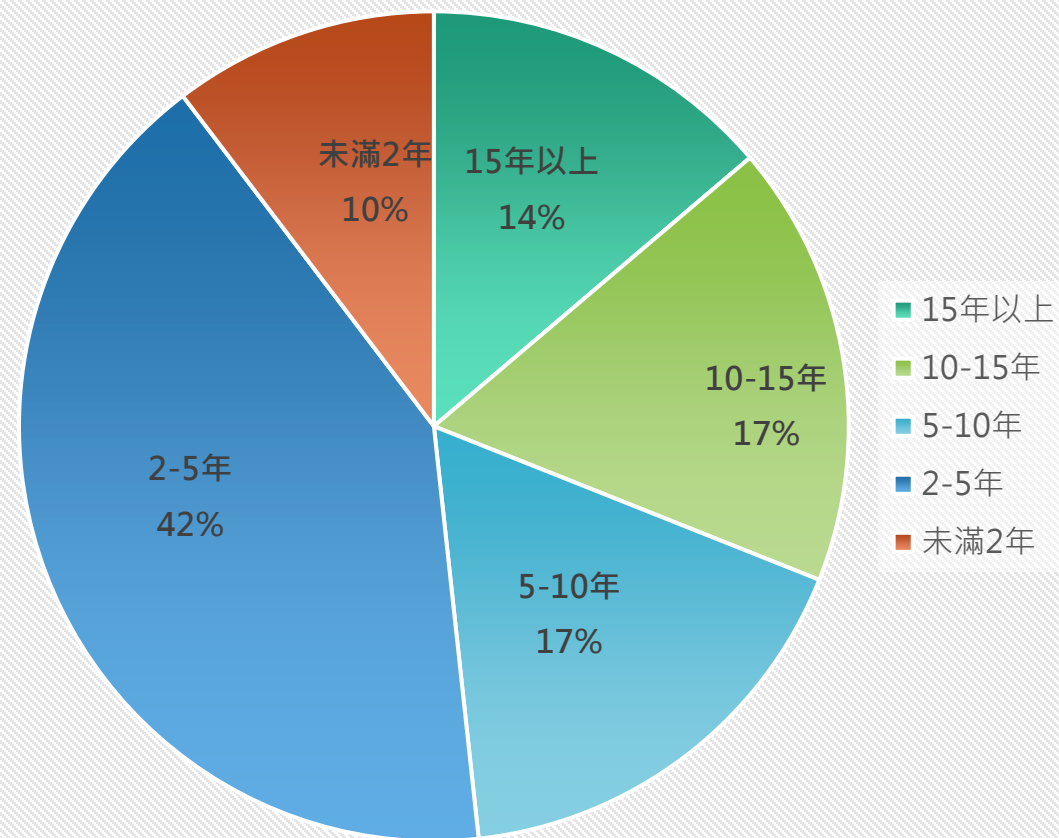
研發人員素質分析

研發人員學歷分佈



截至2025年6月30日之員工資訊
>90%具有碩博士學歷

研發人員產業總年資



截至2025年6月30日之員工資訊
5年以上約48%

技術優勢及競爭利基

深耕系統解決方案市場

本公司投入此市場較早，已累積大量的成功案例及客戶群，故有此領域最需要的「方法」及「產業經驗」，與客戶黏著度高(>80%的回購率)。

提供全方位解決方案及自製操作手冊

由於各產業研發技術涉及各種應用層面，唯有「整合」方能有效提供解決方案以達到客戶需求；另，本公司在提供解決方案時亦提供相關流程及教學手冊或影片，使客戶更仰賴本公司之技術及服務。

最短時間內提供設計結果

本公司投入此市場較早，已累積大量的成功案例及客戶群，故有此領域最需要的「方法」及「產業經驗」，與客戶黏著度高

本公司具備多耦合物理場技術並累積大量開發技術知識庫，且擁有多元的碩博士學歷工程師群(機械/航太/化工/化學/造船/電機電子)，經過長期培養可更快速解決客戶問題，大幅縮短客戶在開發上所需花費之時間及人力成本，此為最大之競爭利基。

系統設計彈性，加速客戶新產品開發週期

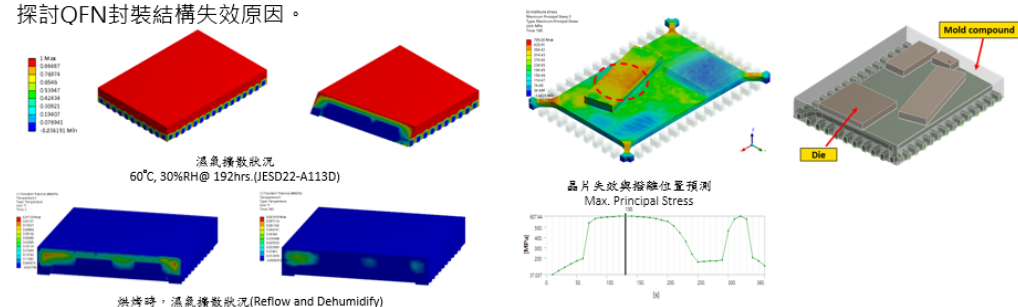
運用多重物理系統設計平台及透過標準化流程與大數據數位化，使產品設計可視化及可預測化，除縮短開發週期，進而提升新產品性價比，並創造創新價值，並與競爭同業做出技術上的區隔。

CAE解決方案成功案例：QFN封裝結構於可靠度模擬性能評估

委案單位：A公司

產業應用：電子封裝可靠度模擬與壽命評估

工程挑戰與創新：現今電子元件結構越趨輕薄，晶片與封裝面積比越接近1，承載的電流密度越高，其耐熱性能與機械應力增加，可靠性與壽命要求越顯嚴格，本案針對可靠度模擬高溫與濕氣測試項目，探討QFN封裝結構失效原因。



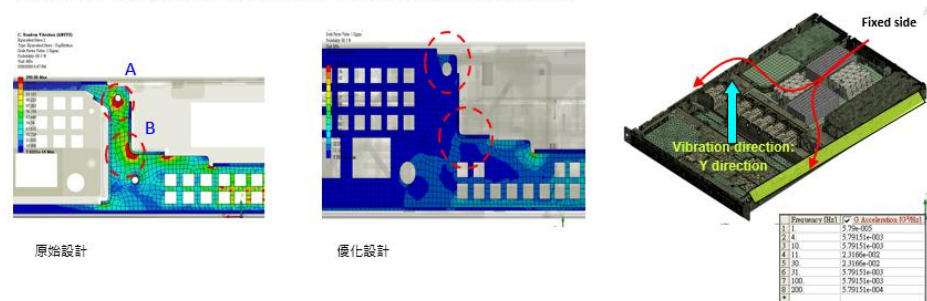
CADMEN 虎門科技

CAE解決方案成功案例：電腦伺服器於隨機振動模擬與優化設計

委案單位：B公司

產業應用：電子產品可靠度模擬與壽命評估

工程挑戰與創新：本案協助客戶進行伺服器機構進行隨機振動測試，透過CAE模擬觀察振動過程中的破壞位置，並提供改善設計建議，完成通過產品振動測試。



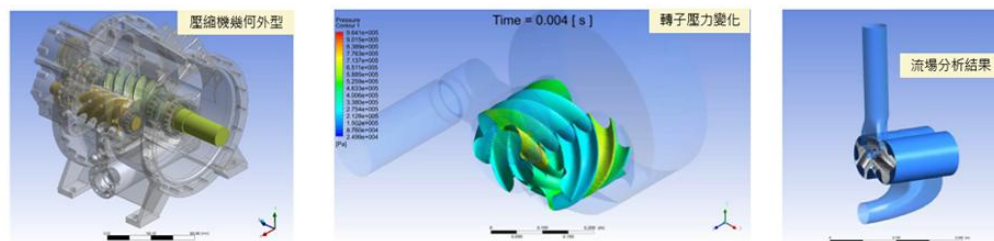
CADMEN 虎門科技

CAE解決方案成功案例：壓縮機模擬分析與優化設計

委案單位：C公司

產業應用：壓縮機產業

工程挑戰與創新：透過模擬分析計算轉子壓力負載、轉子扭力、空氣壓縮比及溫度與流場分佈，優化轉子之齒型、螺距、間隙之幾何外型，提升壓縮機效能。



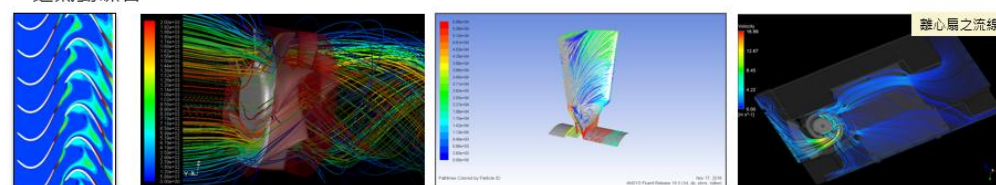
CADMEN 虎門科技

CAE解決方案成功案例：散熱風扇模擬分析

委案單位：D公司

產業應用：風扇產業

工程挑戰與創新：針對直流風扇、節能風扇、薄型離心扇及風扇陣列產品，設計著重於高可靠性及長壽命，兼具低噪音、高效率及環保節能。透過模擬可針對葉片翼型流場進行精準之分析，探討渦流、剝離影響葉片之效能，葉片流量與壓差之操作曲線，計算擺放於系統中的散熱效果，並探討紊流產生之氣動噪音。



CADMEN 虎門科技

工作項目	執行情形與預期效益說明
基於機器學習之化學機械拋光(CMP)製程參數預估平台	1. 建立CMP機械與化學參數相對於拋光結果的相關性 2. 以機器學習演算法，訓練能夠準確推估拋光結果的模型 3. 發展一平台，使用者輸入機械與化學參數後，取得相應的拋光結果推估數據 4. 預期此平台能夠輔助Slurry配方之設計與CMP參數之快速推估
以人工智慧辨識為基礎之高效建模平台－應用於智慧手持裝置與筆記型電腦之設計	1. 已協助國際性智慧型手機、筆記型電腦廠商進行平台開發。 2. 預期大幅提升研發人員之工作效率。 3. 成果可擴展至智慧手持裝置相關產業。
全自動半導體電路結構模擬平台RobotAnalyzer	1. 針對客戶需求進行客製。 2. 由Layout (.gds)全自動轉換為有限元素結構分析模型。 3. 全自動運行運算、提取數據並產出分析報告。 4. 預期節省客戶70%以上用於建模與數據提取的時間
複雜計算環境之計算資源監控平台	1. 整合監控多使用者與多運算伺服器環境。 2. 同時監控電子電路、結構與幾何設計軟體之用量。 3. 提供各種監控統計數據，包含異常用量之智慧判讀。
齒輪組之性能評估分析平台	1. 開發客製幾何引擎自動生成幾何模型，節省設計時間並提高效率。 2. 建立可供參數設定、分析、檢視及結果輸出之平台。 3. 即時運算和分析功能，讓用戶能夠快速獲取結果並進行調整。 4. 通過圖表直觀展示分析結果，提供詳細的齒輪組性能評估指標，便於理解和決策。
互動式即時運算分析平台	1. 平台能夠即時運算和分析數據，提供快速的反饋，幫助用戶做出及時的決策。 2. 用戶可以與平台進行互動，調整參數並立即查看結果，提升使用體驗和效率。 3. 利用FMU進行預測，能夠提供高精度的模擬結果，確保分析的可靠性。 4. 支持多種參數設定和調整，適應不同的分析需求和場景。
無塵室落塵模擬－即時互動虛擬平台	1. 整合Ansys Discovery即時模擬自動化代碼腳本，主要進行落塵模擬CFD問題，並將優化結果顯示於平台。 2. 建置網頁互動虛擬平台，透過API連結伺服器。 3. 使用者無需於本機安裝Ansys即可操作，可自行布局機台位置，即時查看落塵分布等模擬結果。 4. 相較以往擬真技術，使用者能更快速地取得結果，提升使用體驗與效率。 5. 預期導入AI使用Bayesin進行優化，並利用NVIDIA Modulus Sym PINNs模型通過神經網絡來模擬落塵問題。

未來發展

PART 06

CAD MEN



*技術領導者

*多角化 豐富化 完整化

*以核心價值持續輔助客戶進步

*提供現在/未來，用戶所需要的最好**服務**

*提供現在/未來，用戶所需要的最好**工具**

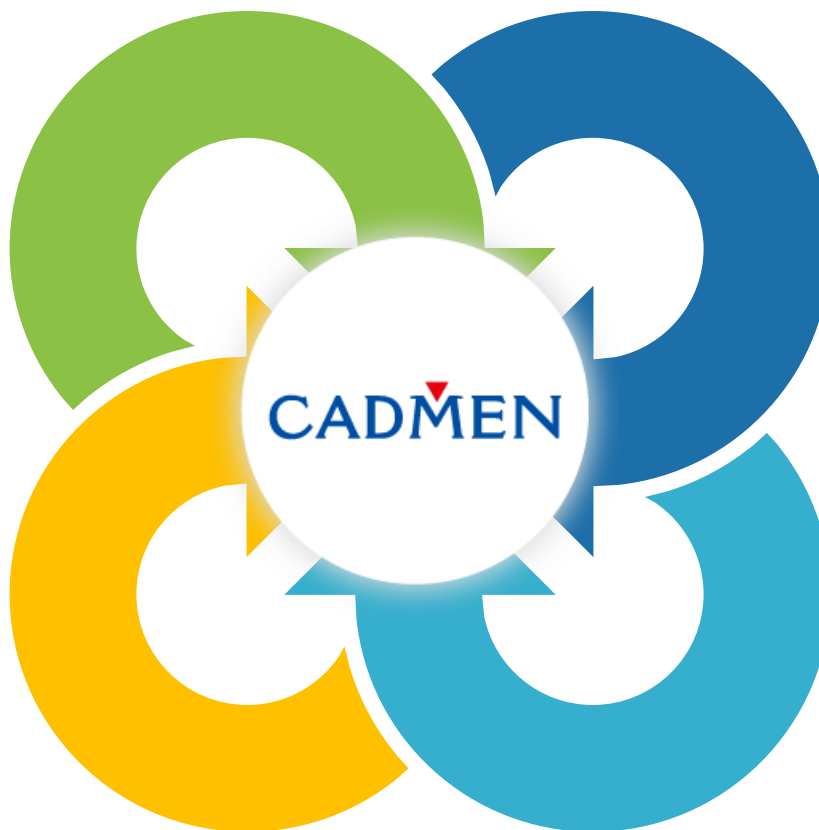
未來發展之有利因素

產品應用產業廣泛

本公司產品應用產業廣泛，且各大產業多需因應資訊科技發展，有固定週期更新軟體或替換之需求，除全球性的景氣衰退外，較**不受單一產業**景氣直接影響，也因此較無明顯之淡旺季區別，而隨著產業別、客戶別逐漸增加，業績得以穩定成長。

與客戶黏著度高

由於本公司推廣Ansys公司之CAE軟體初期係從學術界深耕，使**學生及教授**均慣於使用Ansys公司之CAE軟體，再逐步拓展至各產業界，擁有比其他競爭同業更長期之往來關係及緊密配合度。



市場需求擴大

隨著**物聯網、工業4.0及人工智慧**等新興資訊科技的發展，帶動資訊系統整合開發及服務之需求，估計全球及台灣資訊服務市場均呈現穩定成長態勢，產業景氣同步成長。

已具備拓展海外市場之根基

本公司經過將近三十年的深耕國內市場，已累積**廣泛之使用者通路市場及產品技術經驗**。本公司除了朝國內地區持續擴大市占率前進外，亦將審慎研擬評估開發海外市場之策略。

強化客戶黏著度，爭取往後每年持續採購之訂單

而本公司具備多元的碩博士學歷工程師群(機械/航太/化工/化學/造船/電機電子)、豐富的解決方案經驗及知識庫，可縮短時間快速提供客戶所需的解決方案

維持良好的服務，並吸引同產業其他客戶

本公司持續再優化模擬的技術，透過經驗的累積，優化及精簡模擬的方法，進而縮短模擬的時程並提高準確度。

掌握科技演進脈絡，第一線陪伴客戶進行各項研究發展

本公司扮演**客戶的研發夥伴**，公司透過與客戶討論解決方案時，可洞悉該產業之未來發展方向，並提早模擬出適合該產業之解決方案，以搶占該產業之發展先機。



提升CAE其他領域 (Non Ansys)

- MedeA：原子鍵的材料分析用於新材料的調配，可協助基礎產業技術提升。
- Flownex：快速、準確、高效地模擬複雜的熱流動環境，適用於熱流系統的設計和優化，熱流動環境，針對包含氫能系統、AI伺服水冷系統、儲能櫃散熱系統等，建構虛擬載台進行熱流系統的設計和優化。
- RecurDyn：多體系統動力學模擬軟體，基本核心功能是多剛體動力學 (MBD) 分析。
- SIGMASOFT：虛擬成型原理的核心是對注射成型中的流動，熱流和材料特性進行逼真的3D模擬。

伺服器/工作站(美超微、神雲(泰安)、聯想等大廠)

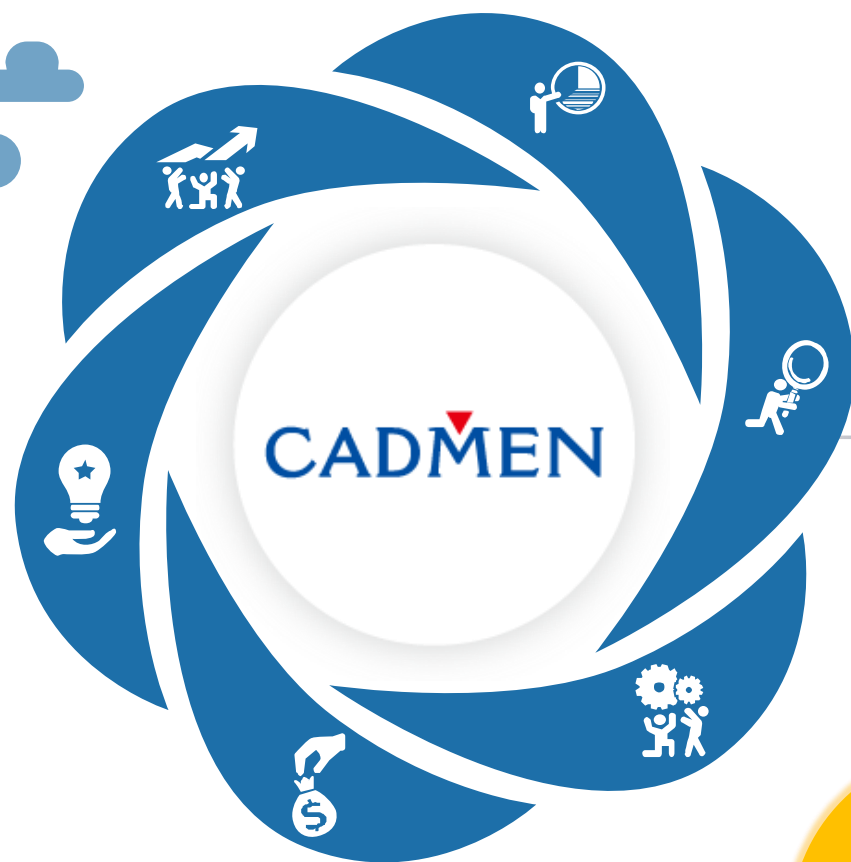
- 將**運算平台與伺服器及工作站整合**。

模擬結果搭配檢測設備進行驗證

- 透過檢測設備量測材料的物理特性等數據，**設計容易使用參數資料**，提高模擬分析結果的準確度，提升服務品質，增加服務客戶能量。
- 聲學及振動檢測技術和設備：
Gfai：噪音量測，聲學照相機設備搭配高速攝影機的WaveCam振動進行分析。
Polytec：雷射都普勒(LDV)振動量測設備及材料表面形貌的光學量測系統白光干涉儀(WLI)。

ESG 永續發展

PART 07



文化

- ✓ 誠信正直
- ✓ 服務至上
- ✓ 持續創新
- ✓ 客戶信任

願景

- ✓ 技術領導者
- ✓ 服務領導者
- ✓ 客戶最堅強的研發夥伴
- ✓ 最具聲譽、以服務為導向，
以及客戶最大整體利益的提供者

維護股東權益 及平等對待股東

- ✓ 111年起股東會增加電子投票方式。
- ✓ 遵循法規以維護股東權益。
- ✓ 無董事與大股東持股設質。
- ✓ 董事長及審計委員會委員出席參與股東會。

強化董事會結構 與運作

- ✓ 公司訂有公司治理守則並經董事會通過。
- ✓ 董事會成員多元化且獨立董事席次過半。
- ✓ 董事及獨立董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修通行要點」規範之時數完成進修。

落實企業社會責任

- ✓ 訂定公司治理實務守則，促進企業永續發展。
- ✓ 積極參與公益活動。
- ✓ 重視員工權益與福利。

提升資訊透明度

- ✓ 公司網站設置投資人專區，以揭露相關訊息。
- ✓ 依重大訊息及資訊申報作業規定，提供投資人攸關可靠之資訊
- ✓ 於公開資訊觀測站定期或不定期公告相關財務及非財務資訊。

- **ESG**分別是**環境保護** (Environmental)、**社會責任** (Social) 和**公司治理** (Governance) 的，以及它們在企業社會責任中的重要性。
- 電腦輔助工程 (Computer-aided engineering; CAE) 在產業界已成為不可或缺的工具，對於研發與製造領域具有關鍵性影響。它有助於提升產品開發的效率，同時在建立環保和節能工廠方面具有重要作用，被視為實現綠色環境轉型的關鍵工具。

硬實力展現 虎門科技已協助全台**20%**焚化爐空汙氣體(氮氧化物)削減：



- NO削減率最高達**65%**
- 將空汙氣體轉化為對環境友善安全的氮氣(N₂)和水蒸氣(H₂O)。

CAD MEN & EY

氣候變遷與永續發展暨ESG諮詢服務

超過
3,800+
位氣候變遷與
永續發展專家

深耕
25+
年永續及ESG
領域諮詢服務

客製化 企業應用

- 彈性組織與主檔管理
- 提供自定義欄位協助分析
- 可依使用者需求客製調整

永續目標 追蹤

- 設定與追蹤年、季、月減碳目標 (2026年版)

全方位碳管理

- 涵蓋範疇一、二、三完整碳排放數據管理
- 自動計算碳排放量，快速生成盤查報告
- 兩階段資料檢核，區分資料狀態

精準數據即時決策

- 支援EXCEL匯入、API串接
- 主檔與活動數據可上傳與檢視佐證文件
- 多版本模擬，提升減碳策略靈活度

高標準資安保障

- 多重權限管理+雙因子認證
- 每日備份，資料完整追蹤

Ansys / Granta

碳盤查的關鍵下一步 碳足跡從Granta開始

產品碳足跡 (Carbon Footprint)

服務或商品在整個生命週期過程所直接與間接產生的溫室氣體排放量。
能源與資源耗用越多，溫室氣體排放量越多，碳足跡越大。



產品碳足跡標籤 (Carbon Labeling)

透過嚴謹的審核程序，傳達產品碳足跡訊息給消費者

「Q & A 意見交流」



Thank You !

CADMEN
Taiwan Auto-Design Co. (TADC)

/// 想瞭解更多訊息，馬上加入我們 ///



▼虎門
官方網站



facebook



YouTube



LinkedIn

